Produktbeschreibung

Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Plattendicke	0,1-5mm
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Farbe		Preis	$ 0,1- $ 10
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3

Verpackung & Lieferung

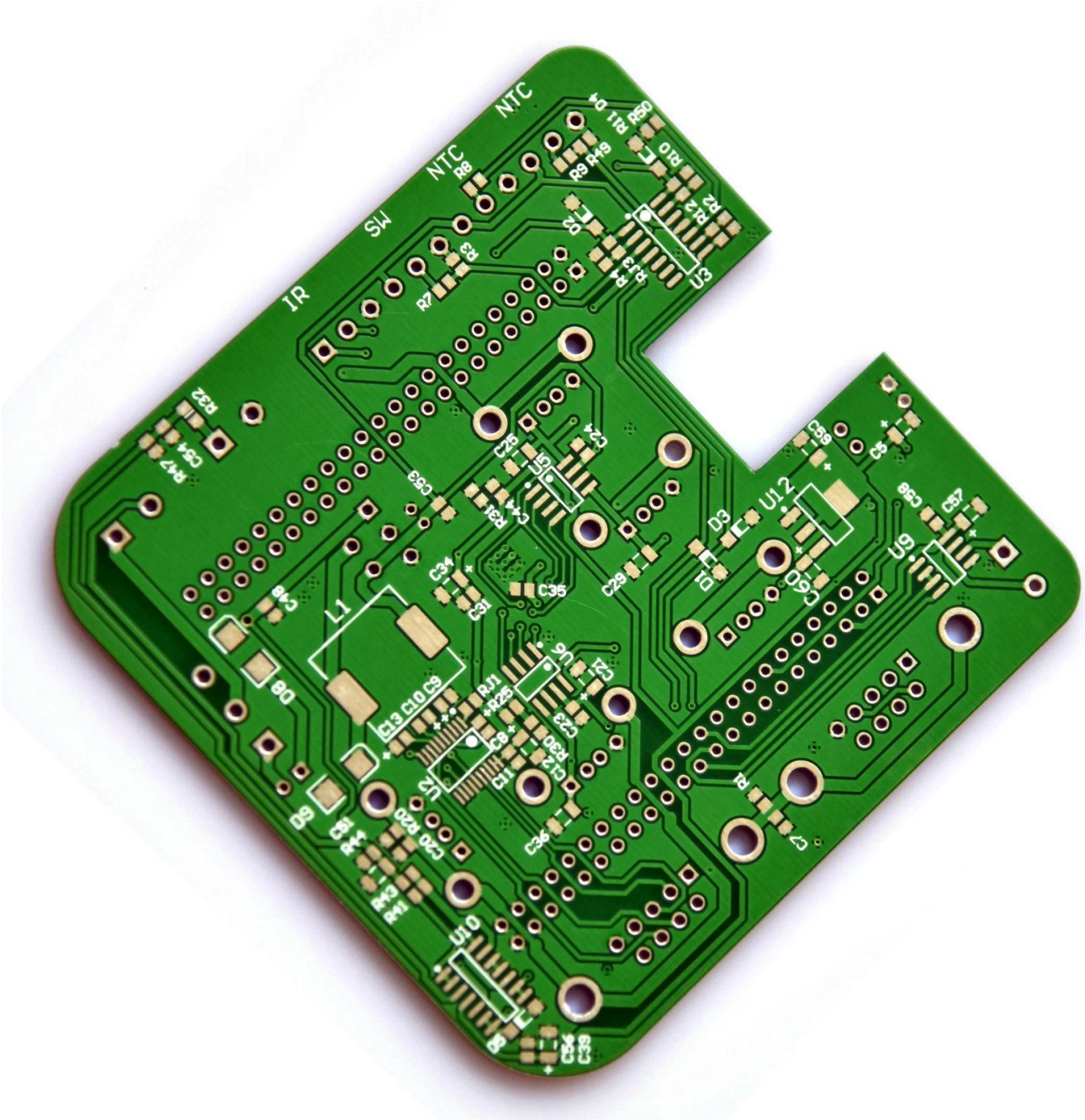
Verpackungsinformationen	16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller
Lieferdetails	7-12days

Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Anzahl der Ebenen	32	42	38	44	42	48
Min Linie / Abstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Irgendeine Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung via	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrdurchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.					
Eingebettete Kondensator-Leiterplatte	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Immersion Silber, Eintauchzinn, Flash-Gold, Gold-Finger-Beschichtung, selektive Hartvergoldung, Peelable Lötmaske, Kohlenstofftinte					

RS485
SERI_MALE
SER2_MALE
USB1
USB2
USB3
USB4
USBSN
SW
VBAT
IBAT
VSOLAR
Rev.C
3/21/2016
INNOVATIVE
Temp



[Doppelseitiger Leiterplattenlieferant, doppelseitiger Leiterplattenhersteller China]